# SMA 机敏结构交替驱动恒流源及其振动控制

姜恩宇, 朱晓锦, 邵 勇, 高志远, 孙 伟

(上海大学机电工程与自动化学院 上海,200072)

摘要 研究了形状记忆合金(shape memory alloy,简称SMA)机敏结构的振动主动控制,为克服SMA的热滞效应, 提高SMA的动态响应速度,提出一种交替驱动SMA驱动组元的控制方案,设计与开发一种多路宽量程SMA交替 驱动恒流源。在简要介绍研究背景与设计思路的基础上,以控制器PIC18F4620单片机和高电压大功率功率放大器 OPA549为核心,详细阐述恒流源系统构成与核心部件、系统软硬件设计思路、功能指标和开发过程。通过构建实 验模型结构和实验平台,进行了基于交替驱动SMA机敏柔性结构振动主动控制实验。实验结果表明,该驱动恒流 源具有稳定恒流控制效果,结合SMA机敏结构交替驱动方案实现结构振动主动控制效果良好,并适用于其他需要 多路大电流恒流源的科研场合。

关键词 交替驱动;恒流源;形状记忆合金;机敏结构;振动控制 中图分类号 TB535;TP13

# 引 言

由机敏材料构成的智能器件(如阻尼器、驱动器等)构造简单,调节驱动容易,耗能小,反应迅速,在 结构振动主动控制中有广阔的应用前景。当前,智能 结构研究中广泛采用了SMA、压电材料和磁致伸缩 材料等机敏材料作为驱动组元<sup>[1-3]</sup>。其中,SMA 以其 特有的形状记忆、超弹性、大变形、高耗能以及良好 的耐腐蚀与耐疲劳性能等独特优势<sup>[4-5]</sup>,被认为是结 构控制中最有前途的驱动材料之一。

基于 SMA 的弹性模量随温度变化而改变的特性,可以实现对结构振动的主动控制<sup>[6-8]</sup>。当前研究 的基本思路是将 SMA 机敏致动材料复合到结构中 去,通过针对 SMA 驱动组元的电流驱动和致热形 变,以改变复合结构的材料力学特性和刚度,从而实 现结构振动主动控制<sup>[9-11]</sup>。SMA 驱动方式和驱动源 特性的优劣程度很大程度上决定了振动控制的可行 性和效率。

笔者以 SMA 机敏结构振动主动控制为研究背景,提出一种多路宽量程 SMA 驱动恒流源设计方案,其技术特性不仅要求具有分布多路驱动功能和 大电流恒流稳定的特点,同时采用数字化控制方式, 具有良好的智能管理功能,进而能够实现针对 SMA 驱动组元的交替驱动控制策略。电路构成上采用 Microchip 公司 PIC18F4620 为核心 MCU,以 TI 公 司 OPA549 芯片作为功放芯片,结合软件开发和功 能设计,完全实现了多路多机恒流交替驱动能力,具 有使用方便和可靠稳定的特点,从而为SMA 机敏结 构振动主动控制研究提供了重要的实验手段和组成 单元。在此基础上,通过构建实验模型结构和实验平 台,基于交替驱动SMA 组元策略进行了结构振动主 动控制实验,取得了良好的控制效果。

# 1 多路交替驱动恒流源设计方案

## 1.1 系统硬件设计

多路SMA 驱动恒流源设计,不仅要考虑恒定大电流稳定输出问题,而且必须考虑放大器的最大转换速率、放大器的输出功率和各项参数,因此功放芯片参数的合理选择至关重要。根据上述技术要求,本系统设计方案如下:采用 Microchip 公司的 PIC18F4620 单片机、D/A 转换芯片 TLC5615 和基准电压芯片LM385-2.5 组成数模转换电路,放大器 OP07 组成放大和跟随电路,TI 公司功率放大器 OPA549 芯片和高精度采样电阻组成恒流源电路,同时以 TOPWAY 公司 320 \* 240 的 LM2088EFW-C 液晶屏组成人机接口电路、

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金资助项目(90716027,51175319);上海市教委"机械电子工程"创新团队资助项目;上海大学"十一五" 211 建设和上海市电站自动化技术重点实验室资助项目 收稿日期:2012-07-31;修改稿收到日期:2012-09-06

485 通信接口电路以及过热和过流保护电路及装置。 图1 为本系统设计原理框图。



图1 恒流源系统设计原理框图

1.1.1 PIC18f4620单片机

MCU系统是整个硬件系统的核心,是实现系统各项功能的控制器。本方案采用微芯公司 PIC18F4620微处理器,构成恒流控制回路的运算控制单元。它采用16位的RISC指令系统、哈佛总线结构、两级流水线取指等技术,具有64kB快闪存内存、4kB的RAM、片内看门狗、内部EEPROM等丰富的片内资源,抗干扰性能好,功耗低,速度高,另外还包括单片机系统必须的振荡和复位电路。设计方案实现4路电流恒流输出,采用单片机的PB3~PB7端口通过20针插排和D/A的片选端CS相连,实现多路电流输出的选择。

1.1.2 D/A 转换电路

采用美国德州仪器(TI)公司的TLC5615高速 高精度10位单通道数字/模拟转换芯片,它采用SPI 数据串行输入、逻辑控制、并行处理、电压输出方式, 单电源供电。采用标准的SPI串行数据输入方式,输 入时钟频率可达1.21 MHz,最低有效位稳定至 0.5LSB,时间仅为12.5 μs,满足SAP,MCU和FP-GA等系统的快速性要求。单片机与D/A转换电路 的连接如图2所示。

1.1.3 信号调理电路和V/I转换电路

经过 D/A 转换的电压信号,连接到放大器



图 2 单片机与D/A 转换电路

OP07的正向端,经跟随放大电路后输入V/I转换电路中OPA549的4脚。根据V/I转换电路中采用的高精度采样电阻的阻值大小,设定跟随与放大电路的放大倍数。

OPA549 是美国 TI 推出的高电压大电流运算 放大器,典型电流值是8 A,最大可以达到10 A。还 可以提供一个准确的、用户可以选择的电流极值,允 许电流极值在 0~10 A 的范围变化,并且这个极限 值可以用一个电阻控制或用DAC 数控。运放本身具 有过热过流保护、转化速率可达9 V/ $\mu$ s、单位增益稳 定以及功率频带宽等特点。其信号调理和 V/I 转换 电路连接如图 3 所示,其中: $R_1$ =30 kΩ; $R_2$ = $R_3$ = 50 kΩ;  $R_4$ = 2 kΩ;  $R_5$  =  $R_6$  =  $R_9$  = 10 kΩ  $R_7$ =1.5 kΩ; $C_1$ =1 000 pF。



图 3 信号调理及 V/I 转换电路

其电路工作原理如下:首先,通过MCU 控制D/ A 转换芯片TLC5615 给定电压U<sub>1</sub>,经过第1级运放 OP07 所组成跟随电路和第2 级运放OP07 反向调零 电路后,输入第3级运放OP07 构成的比例放大电 路;然后,输入到OPA549 的同向端,此时OPA549 的同向端得给定电压为

$$U_{+} = \frac{R_{7}}{R_{5}}U_{1} \tag{1}$$

由采样电阻R。的一端与OPA549的反向端相连构成了一个电流负反馈回路,此时

$$U_{-} = IR_{\rm s} \tag{2}$$

因为

$$U_{+} = U_{-} \tag{3}$$

所以

$$\frac{R_7}{R_5}U_1 = IR_s \tag{4}$$

驱动 SMA 的输出电流与流过采样电阻的电流 始终是相等的,所以只要 MCU 给定 U<sub>1</sub>,那么驱动 SMA 的电流与流过采样电阻的电流就为

$$I = \frac{R_7}{R_5} \frac{U_1}{R_s} \tag{5}$$

采样电阻串联在负载回路内,通过采样电阻检 测负载电流的变化,并把电流信号转换成电压信号 反馈到OPA549的反向端;因此,采样电阻的稳定性 将直接影响到恒流源的性能。因为电流比较大,所以 采样电阻还应有足够大的功率,否则也会影响恒流 源的性能甚至烧坏。综合以上各因素,在实际电路中 选用了大功率锰铜材料制成的精密电阻,其温度系 数达到(-3~20)×10<sup>-6</sup>/℃,本方案中采样电阻加 上导线电阻,经电桥测量的电阻值为36.7 mΩ。

1.1.4 人机接口界面

界面包括液晶显示输出和键盘输入两部分。选用 320 \* 240 的 TOPWAY 图 形点 阵式液晶 LM320240,可以满足文字、波形、图片等数据信息 的显示要求。键盘检测芯片选用ZLG7289B,不仅具 有非常方便的 SPI 通信接口,还具备较宽的供电电 压范围,很适合 5V/3.3V 测控单元的开发需要。本 方案的各项电流参数数据通过液晶显示,触摸电阻 屏可作为人机接口的输入部分,通过测量按下触摸 屏的 x,y 坐标来判断用户的输入选择。

1.1.5 与DSP及PC 机通信的 485 通信

为实现 DSP 或 PC 机对本系统的多路控制,采 用485 通信方式,以便于实现多机通信。其通信结构 如图 4 所示。



图 4 DSP, PC 机和多个恒流源的 485 通信结构图

由于SMA 散热较慢,所以在实际应用中需多路 恒流源用来交替驱动多路SMA 驱动单元。这样当一 路SMA 驱动单元冷却时,PIC18F4620可以控制其 他 SMA 驱动单元致动,并通过 SPI 总线控制 TLC5615,因此1片PIC18F4620可以控制4路恒流 源驱动输出单元。

### 1.2 系统软件设计

软件设计采用模块化编程方式,主要包括主程 序、数据接收发送中断程序、定时器中断处理程序、 数据处理程序、上位机控制程序。将相应的功能设计 成相对独立的子程序,最后由主程序实现调用。

1.2.1 系统主程序设计

完成所有外围器件的初始化,设置外部中断和 定时器中断,用于控制信息的发送。数据发送接收中 断服务程序负责接收发送数据,并把数据放到相应 的数据区,判断数据是否需要立即处理。电流的开通 和关断对实时性要求比较高,故采用定时器中断的 方式进行处理。首先,微处理器PIC18F4620在程序 开始时对SPI控制器模块进行初始化,确定SPI总线 的传输速率;然后,确定恒流源单元所对应地址。微 处理器PIC18F4620通过I/O口对恒流源单元进行 选择,再通过SPI接口和定时器对D/A转换的电流 大小和通电时间进行控制,通过电流串联负反馈在 负载端就有相应大小的恒定电流按照一定的时间输 出。其主程序和数据接收发送中断程序流程如图5 所示。



图5 主程序、数据接收和发送中断程序流程图

1.2.2 数据处理程序和D/A 转换程序

微处理器 PIC18F4620 接收到上位机发送的正确数据后,进入数据处理程序和 D/A 转换程序。首先,在数据处理中先接收通道号,打开通道;然后,接收电流大小数据,调用 D/A 转换子程序;最后,接收通电时长,这时调用定时器中断开始计时,时间到时关闭选中通道。其程序流程图如图 6 所示。

为了实现交替驱动SMA 驱动单元,要对恒流源 装置的各路电流大小、通电时间以及延迟时间进行 设置,上位机控制软件采用VC6.0编译平台实现 具体控制界面如图7所示。

当计算出某一恒流源的电流大小、开始时间、持续时间后,通过上位机控制程序设定控制策略,发出 帧格式命令给相应地址的恒流源装置。由于总线上 有一定数量的恒流源装置,对应地址的恒流源装置



图 6 数据处理和 D/A 转换程序流程图

8天区 这是一个记忆合金!	主筆动控制软件)	通道设置区 通电时间 65) 通电电流 643			
		通過101:	500	0	RIEDO
		<u>itiite</u> :	500	0	1.2.2EE2
		<u>i#inco</u> :	500	0	发送指令。
		186804;	500	0	参議議会
		通道:105:	\$00	0	发送指令
		Eigos :	500	0	335.1810
		<b>Millio</b> 7:	500	0	教廷國家
		illilles :	500	0	MIEIS?
		約4月19月27日1月11日1月11日1日			
			EUG(S)	(HR)JOLIEIZ	(1658 යෝ)
		illino1:	10000	0	
		通道:202:	10000	1000	Ginned
1288114 : 00:00	00	inimos :	10000	2000	一般ない
		通道04:	10000	3000	
通讯设鉴区		通過1805;	10000	4000	
2006 3094: 2006 3094:	COMI +	illinos :	10000	5000	100 11- 100 11-
	- 100U	)Billior:	10000	6006	
	NEFBOON/EPP	iRidice :	10000	1000	

图7 上位机控制程序界面

收到后,对数据进行解析,输出相应时间、大小的电流。在本方案中为了实现DSP或PC机对多机多路 恒流源的控制,采用485的通信方式,以便于实现多 机通信。通讯波特率为19200 bit/s,构建协议格式 主要由同步位、从机地址位、命令字(区分不同功 能)、数据域(根据命令字不同而不同)和校验(累加 和校验)5部分组成。

## 2 实验平台与验证

#### 2.1 实验模型结构

采用SMA 机敏复合结构模拟飞行器蒙皮,基材 选择环氧树脂板,主要参数为:弹性模量  $E_{\sigma} =$ 22 GPa,泊松比 $\nu = 0.3$ ,密度 $\rho = 2$  100 kg/m<sup>3</sup>,厚度 为2 mm,具体尺寸如图8 所示。取直径为0.5 mm 的



图 8 SMA 蒙皮结构形态与尺寸

单程 NI-TI 形状记忆合金丝 SMA,首先,进行热冷循环实验,使其力学行为达到稳定,并可单程反复使用;然后,截取长度为794 mm 的形状记忆合金丝进行预应变,形变为5%,拉伸后记忆合金丝长度为803 mm,并测得单根预拉伸 SMA 丝电阻为3.163 Ω。在基体材料板上共布置16 根预拉伸 SMA 丝,两端分别用接头螺丝进行固定并接出驱动导线端,同时采用固化胶将 SMA 丝与基体板进行粘贴形成一种SMA 驱动机敏柔板结构。在此基础上,将所设计制作的 SMA 驱动机敏柔板结构安装在模拟飞行器框架实验模型上,以构成机敏蒙皮结构,粘贴4 个 PZT 压电片作为结构振动检测传感器,尺寸为20 mm×6 mm×0.4 mm。实验模型如图9 所示。



图 9 模拟 SMA 机敏蒙皮结构的实验模型结构

#### 2.2 实验平台构建

实验平台主要由固定支撑架构、实验模型对象、 高性能计算机、BK 振动分析仪、信号发生器、示波 器、功率放大器、多路驱动恒流源等组成,同时设计开 发了相关测控软件环境,具体构成方式如图10 所示。



图 10 实验平台组成方式示意图

采用信号发生器并经宽频压电驱动功率放大器 产生激振信号,施加于模型结构使之持续振动,4路 传感PZT感知结构振动信号,实验平台构建如图11 所示。



图 11 实验平台与环境构成图

## 3 振动主动控制实验

经过扫频实验,得出实验对象的1阶固有频率 为f=18.70 Hz,为有效激励结构振动。施加f= 18.70 Hz 的激励信号于功率放大器,并通过激振器 激励模型结构进入持续振动状态。基于实验平台和 测控软件启动 SMA 交替驱动控制,同时驱动4路 SMA 驱动单元,施加激励电流为4 A,激励时间为 0.5 s,并在16根 SMA 驱动单元间进行交替循环驱 动,总激励时间为30 s。经4路压电传感器采集结构 振 动响应时域信号,获得结构控制效果如图 12 所示。

由图 12 可见,在驱动 SMA 进入振动控制状态 后,持续的结构强迫振动响应在经过3 s 之后开始受 到主动抑制,并在8 s 之后抑制到一个较低的水平。 实验过程中也发现,施加控制后由于结构动力学特





图12 实验模型各通道振动控制时间历程

性发生一定的改变,个别传感器所布位置已偏离最优结构振动检测点,导致结构振动控制效果反应不明显,如图12(d)所示。结构整体振动响应大幅降低表明,基于SMA 交替驱动的机敏结构振动主动控制是有效的。

## 4 结束语

笔者针对SMA 驱动机敏结构振动主动控制研究,采用了一种SMA 交替激励驱动控制方式,并据 此设计与开发了一种多路宽量程SMA 交替驱动恒 流源,在此基础上构建了实验模型结构进行振动主 动控制验证。由于模型结构基板上埋入多组SMA 驱 动单元,每次仅驱动其中的一部分,同时交替循环进 行 SMA 驱动单元的激励,可在一定程度上克服 SMA 的热滞效应,提高了SMA 机敏结构振动主动 控制的效果。研究过程也发现,SMA 驱动材料性能 存在不稳定性,材料正逆相变特性与响应速度也存 在较大的差别;因此,机敏驱动材料特性仍是制约工 程应用的一个关键环节。

#### 参考文献

- [1] Dhanalakshmi K, Umapathy M, Active vibration control of SMA actuated structures using fast output sampling based sliding mode control[J]. Instrumentation Science and Technology, 2008, 36: 180-193.
- [2] 钱振东,沈建华,黄卫,等.采用压电陶瓷元件进行智能 板振动控制[J].振动、测试与诊断,2000,20(3):196-226.

Qian Zhendong, Shen Jianhua, Huang Wei, et al. Vibration control of smart plate using piezoelectric ceramic units[J]. Journal of Vibration, Measurement &. Diagnosis,2000,20(3):196-226. (in Chinese)

[3] 王福吉,贾振元,刘巍,等.复合薄膜磁致伸缩系数求解 及悬臂梁结构优化[J].光学精密工程,2011,19(8): 1832-1837.

Wang Fuji, Jia Zhenyuan, Liu Wei, et al. Calculation of magnetostrictive coefficient of composite thin film and structure optimization of cantilever [J]. Optics and Precision Engineering, 2011, 19(8): 1832-1837. (in Chinese)

- [4] Shuzhi S G, Keng P T, Ivan E V, et al. Tracking and vibration control of flexible robots using shape memory alloys [J]. IEEE Transactions on Mechatronics, 2006,11(6):690-698.
- [5] 朱晓锦,陆美玉,赵晓瑜,等.光纤机敏结构振动形态感 知及其SMA 致动控制[J].振动、测试与诊断,2008,28
   (4): 327-410.

Zhu Xiaojin, Lu Meiyu, Zhao Xiaoyu, et al. Vibration shape perception and SMA actuating control of fiber optic smart structure[J]. Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis, 2008, 28(4): 327-410. (in Chinese)

- [6] Kaori Y, Yoshihiro. Development and experimental consideration of SMA/CFRP actuator for vibration control [J]. Sensors and Actuators, 2005 122: 99-107.
- [7] Sohn J W, Han Y M, Choi S B, et al. Vibration and postion tracking control of a flexible beam using SMA wire actuators[J]. Journal of Vibration and Control, 2009, 15(2): 263-281.

 [8] 王晓宏,张博明,杜善义,等.形状记忆合金驱动主动变 形波纹板结构的有限元分析[J].机械工程学报,2009, 45(8):287-291.
 Wang Xiaohong, Zhang Boming, Du Shangyi, et al.

Finite element analysis of corrugated sheets structure deforming initiatively with shape memory alloy actuators[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2009, 45 (8): 287-291. (in Chinese)

- [9] Melin S, Fatih M K, Yavuz Y. Smart structures and their applications on active vibration control: studies in the department of aerospace engineering, METU [J]. Journal of Electroceramics, 2008, 20:167-174.
- [10] 王军,郦正能,叶宁.形状记忆合金智能结构的主动振动抑制研究[J].航空学报,2002,23(5):427-430.
  Wang Jun, Li Zhengneng, Ye Ning. Research on active vibration suppression of smart structure embedded with shape memory alloy[J]. Acta Aeronautic Et Astronautica Sinica, 2002, 23(5): 427-430. (in Chinese)
- [11] He Yongyong, Satoko O, Chu Fulei, et al. Vibration control of a rotor-bearing system using shape memory alloy: theory[J]. Smart Mater & Struct, 2007, 16 114-121.



第一作者简介:姜恩字,男,1981年5月 生,博士研究生。主要研究方向为控制理 论与控制工程、测控技术及仪器等。曾发 表《小波包分析和支持向量机用于直肠 感知功能重建》(《应用科学学报》2012 年第30卷第5期)等论文。 E-mail:Enyu.1981@163.com

通信作者简介:朱晓锦,男,1965年12月 生,博士、教授、博士生导师。主要研究方 向为先进测控与信息处理、智能结构主 动监控等。

E-mail:mgzhuxj@shu.edu.cn